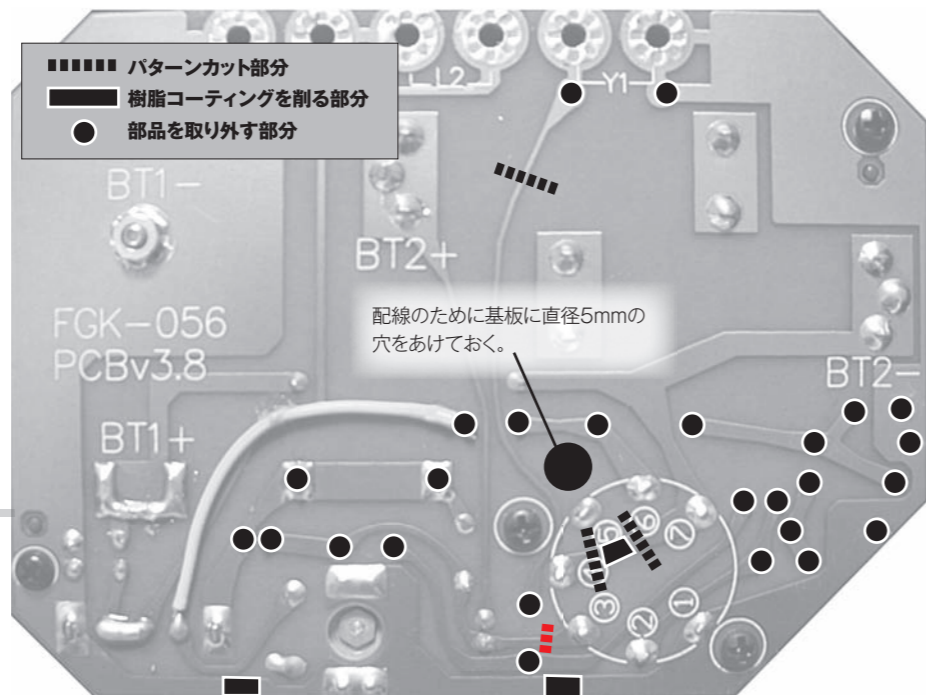


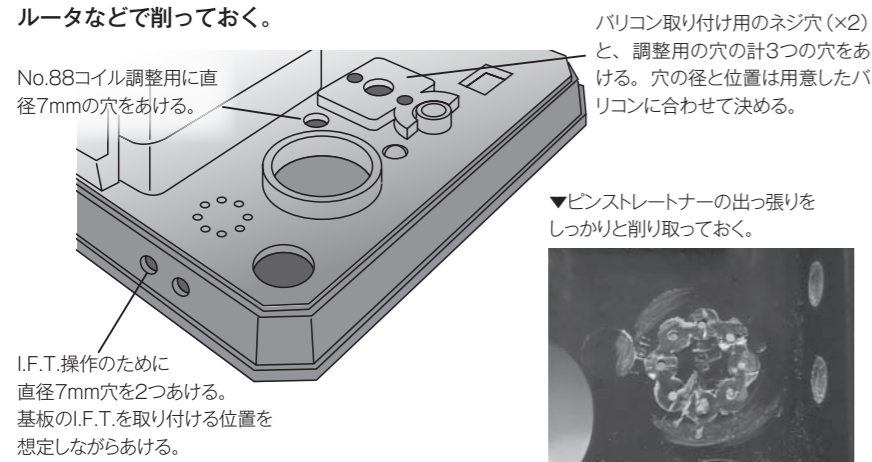
2 基板のパターンカットおよび、樹脂の削り取りを行う

右図を参考にして、基板のパターンカットと追加部品を取り付ける場所の樹脂コーティングを削り取る。パターンカット、および樹脂の削り取りは、36 ページを参照して、カットする部分は基板のベースまで削り、樹脂を削る部分はパターンの金属がむき出しになるようにする。



3 本体を加工する

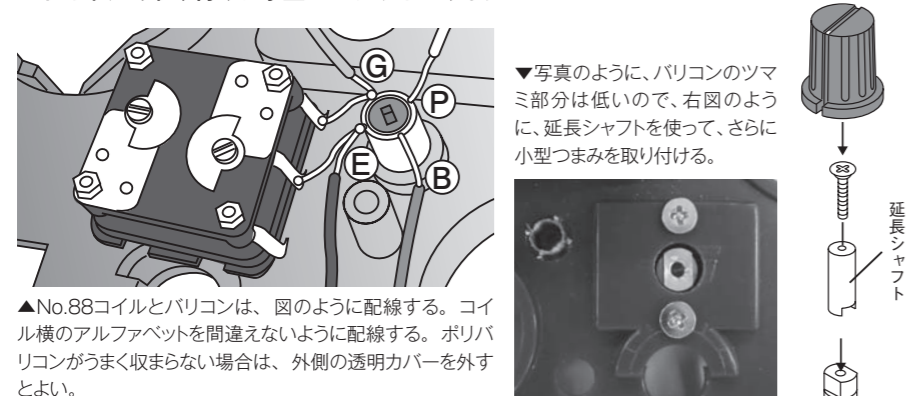
図のように本体に穴をあける。穴あけは、できればドリルを使いたい。本体裏側のピンストレートナーの出っ張りの部分には、基板上に取り付けたI.F.T. がぶつかるため、ルータなどで削っておく。



4 ポリバリコンと No.88 コイルを本体裏側に取り付ける

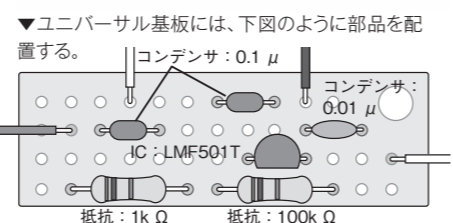
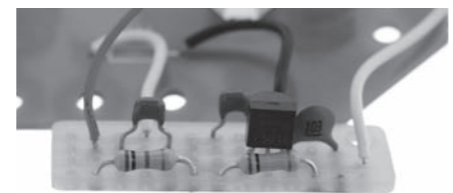
本体上面にあけた穴に、No.88 コイルとポリバリコンを取り付ける。No.88 コイルはエポキシ系樹脂で接着、ポリバリコンはネジ止めする。

両方を取り付けたら、下図のように配線する。バリコンのつまみ部分には、延長シャフトをネジで取り付け、小型のつまみをつける。

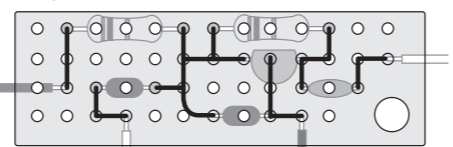


5 IC などの部品をユニバーサル基板に取り付ける

ユニバーサル基板をつかい、コンパクトにICなどの部品を配線する。下図を参考に、部品があまり基板から出っ張らないよう注意しながら、本体内部にすべてが収まるように半田づけを行う。

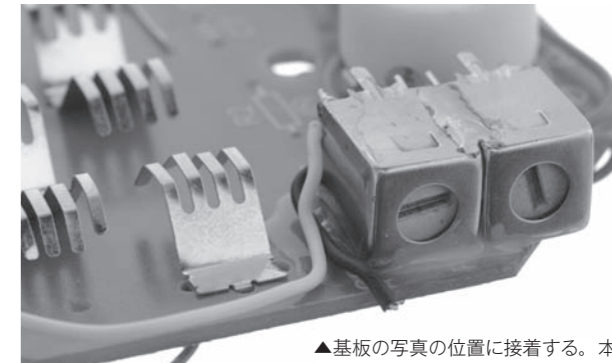
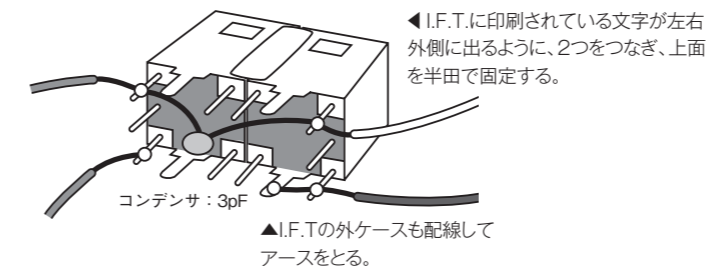


ユニバーサル基板を裏からみた状態、実線の部分を半田でつなぐ。部品のあしをうまく使いながら配線しよう。



6 I.F.T. を基板に接着する

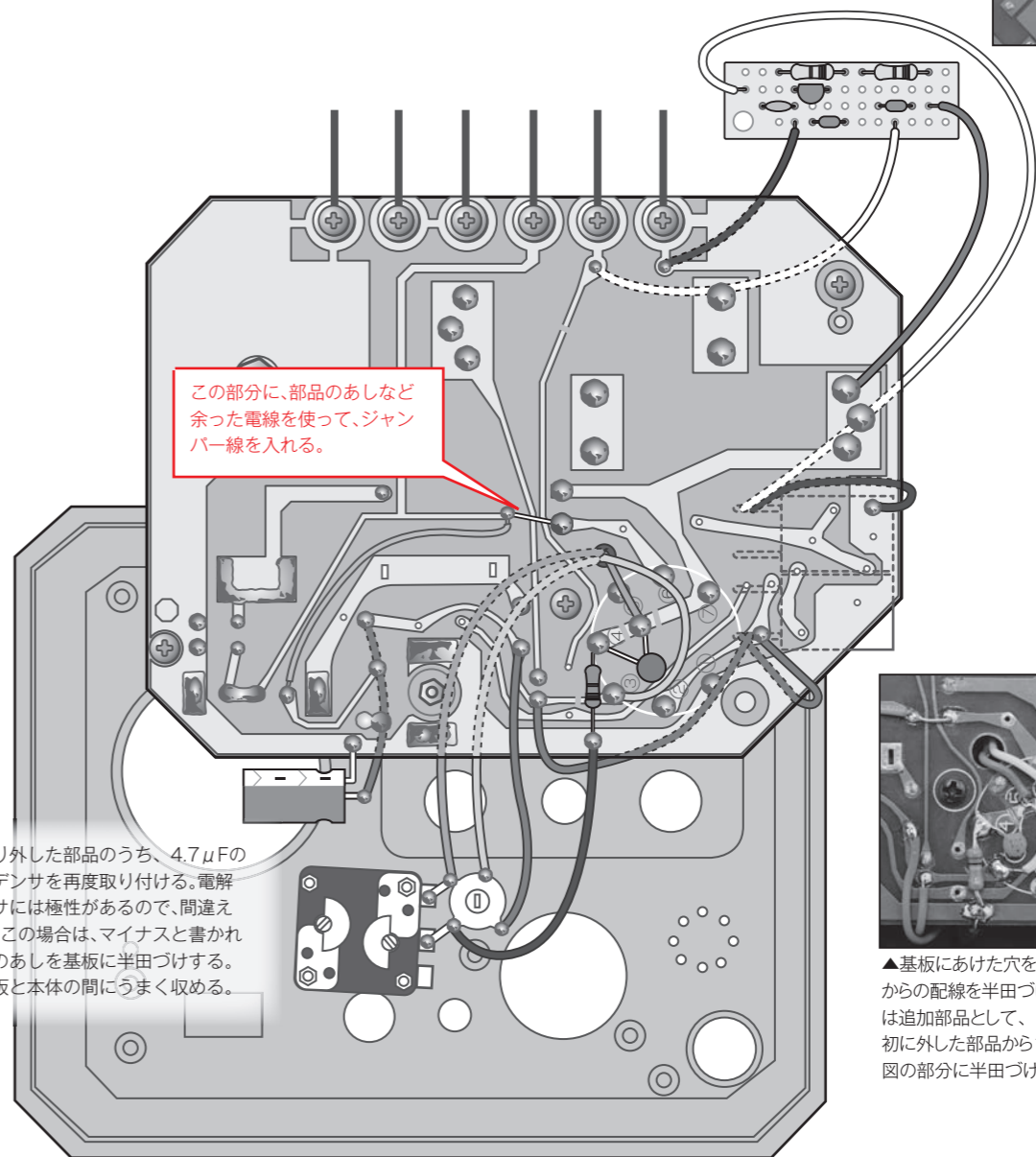
最初に、2つのI.F.T. を半田で接着しておく。下図のようにコンデンサおよび線材を半田づけし、エポキシ系接着剤で基板に接着する。



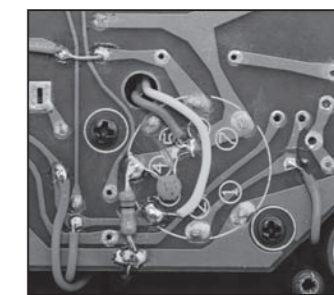
▲基板の写真の位置に接着する。本体にあけた穴とうまく合うように、位置を微調整してから接着する。

7 オリジナル基板への部品追加および配線

最後に、下図を見ながら間違えないように配線を行う。



▲ユニバーサル基板は、本体にネジなどで固定すると安定する。



▲基板にあけた穴を通して、局発コイルからの配線を半田づけする。この部分には追加部品として、100kΩの抵抗と最初に外した部品から100pFコンデンサを図の部分に半田づけする。